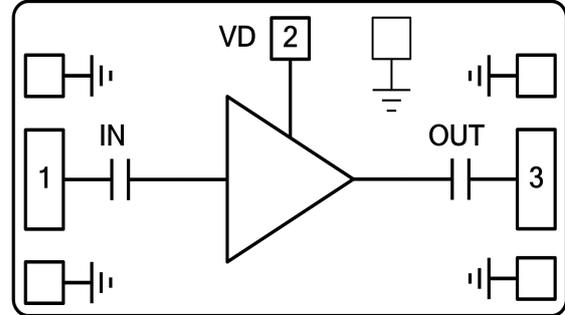




主要特点

- 工作频率: 2 - 4 GHz
- 噪声系数: 0.6 dB
- 增益: 29 dB
- P1dB: +14 dBm
- 自偏置供电: +5 V @ 33 mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 1.5 × 1.0 × 0.1 mm³

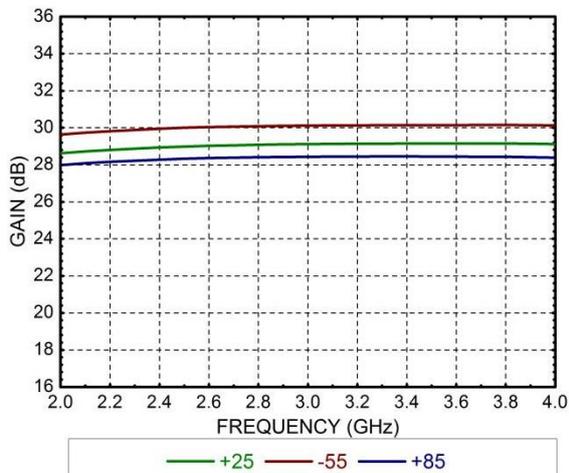
功能框图



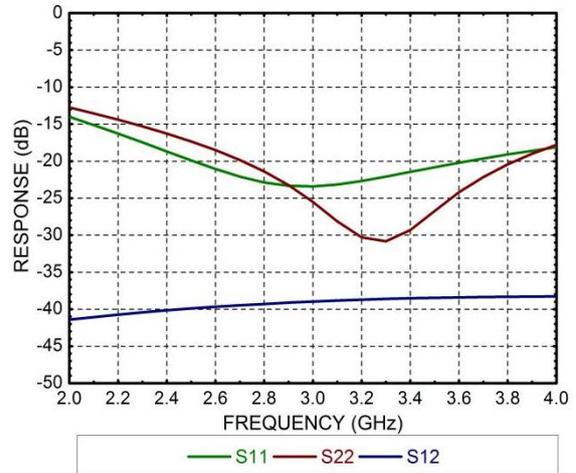
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $VD = +5\text{ V}$, $IDD = 33\text{ mA}$)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 4			GHz
增益		29		dB
增益平坦度		±0.3		dB
输入回波损耗		17		dB
输出回波损耗		17		dB
输出功率 1dB 压缩点		14		dBm
饱和输出功率		15		dBm
输出 IP3		23		dBm
噪声系数		0.6		dB
工作电流	20	33	50	mA

增益

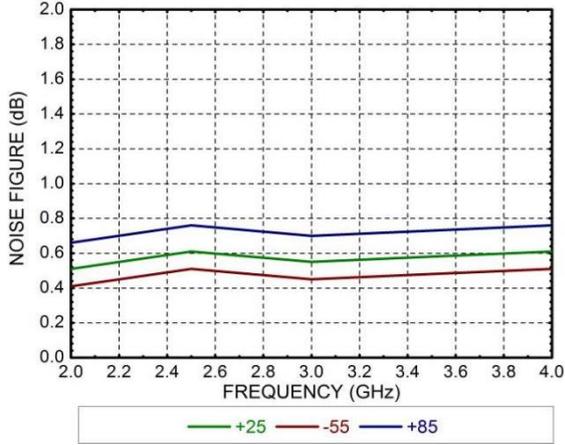


回波损耗&反向隔离

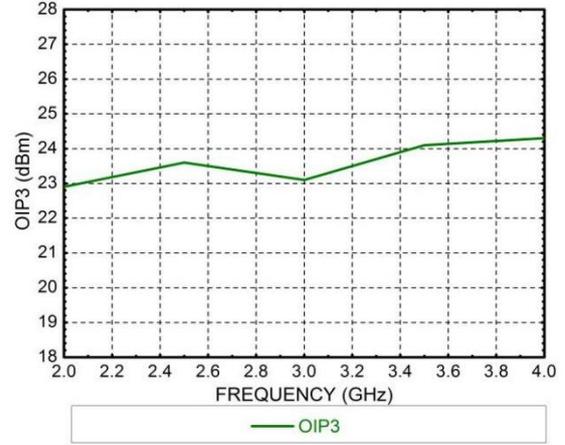




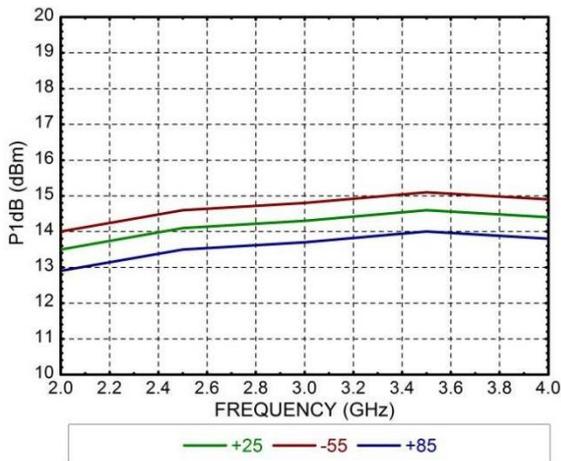
噪声系数



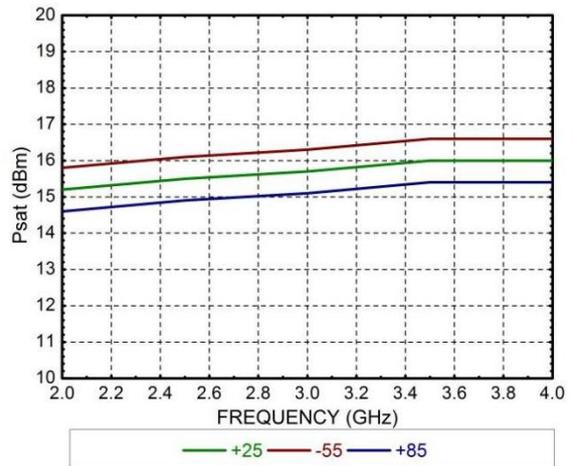
OIP3



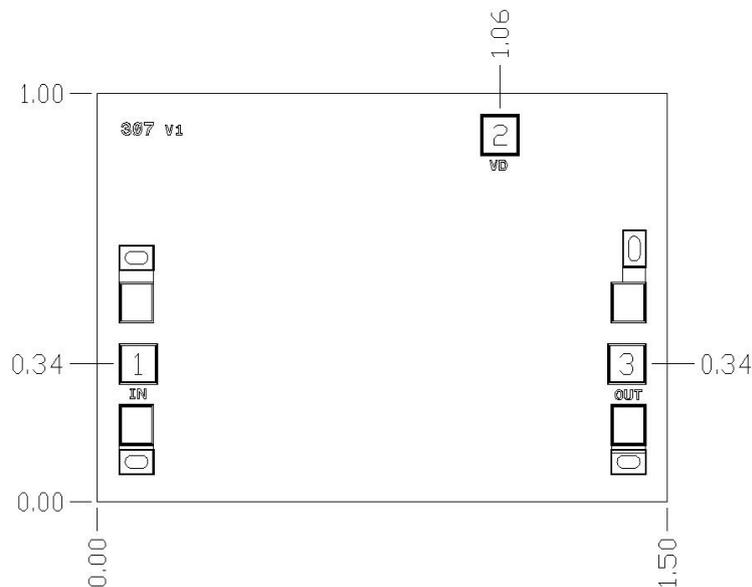
输出功率 P_{1}



输出功率 P_{sat}



物理参数

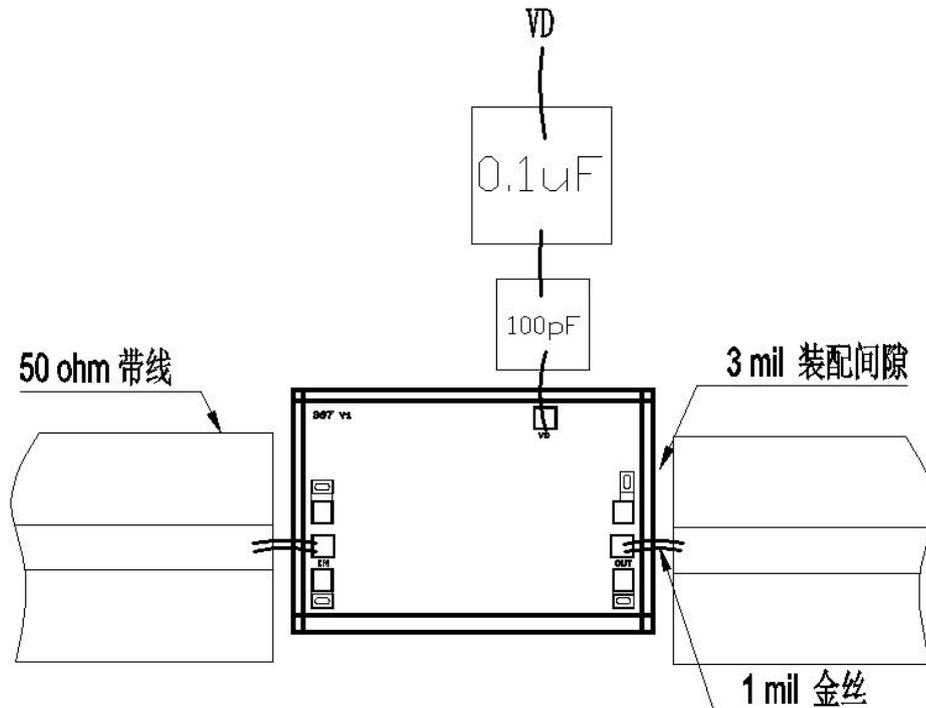




焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 AC 耦合，并匹配至 50 Ohm
2	VD	该焊盘提供放大器的电源电压，需要外接 100pF 旁路电容
3	OUT	该焊盘是 AC 耦合，并匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地。

装配图



注意事项

1. 芯片厚度为 100 μm
2. 典型键合焊盘尺寸为 $100 \times 100 \mu\text{m}^2$
3. 键合焊盘金属化：金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

1. 电源电压：+6 V
2. 射频输入功率：+18 dBm
3. 储存温度：-65 ~ +150 $^{\circ}\text{C}$
4. 工作温度：-55 ~ +85 $^{\circ}\text{C}$